

希荻微电子集团股份有限公司

关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的

半年度评估报告

为积极响应关于开展科创板上市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议，落实以投资者为本的理念，推动希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）持续优化经营、规范治理和积极回报投资者，大力提高公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展，公司制定了《希荻微电子集团股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）并已于 2024 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露。公司现对行动方案在 2024 年上半年的实施情况进行全面评估并编制了本评估报告，具体内容如下：

一、“专注公司主业，持续提升核心竞争力”相关措施的实施情况

（一）“持续扩充产品料号以满足下游应用多样化需求”的实施情况

2024 年上半年，公司聚焦下游应用场景，推出了多款新产品，为客户提供了更卓越的完整解决方案，主要推出的新产品情况如下表所示：

序号	产品线	产品型号	应用领域
1	锂电池充电系列	如开关充电芯片 HL7009A、开关电容充电芯片 HL7137 等	智能手机、平板电脑、移动物联网设备
2	车载电源系列	如车载 LDO 稳压芯片 HL8743、车载高边开关芯片 HL8518 和 HL8545、HL8545G 等	服务器、汽车电子
3	端口保护系列	如音频和数据开关芯片 HL5281、USB 端口保护和负载开关芯片 HL5075 等	智能手机、平板电脑、笔记本电脑、移动物联网设备
4	高性能 DC/DC 系列	如升压稳压芯片 HL7603 等	智能手机、平板电脑
5	马达驱动系列	如智能功率模块芯片 HL9901 和 HL9904 等	工业、家电

其中，新产品 HL7603 为市场上首款专为硅阳极锂离子电池设计的 DC/DC 芯片，可大幅提高电池的电量输出和提高电池续航能力，为 AI 手机高效运转保驾护航。HL7603 使得公司脱颖而出，抢占了宝贵的市场先机。

2024 年 1 月，公司电荷泵充电芯片 HL7139 以及降压转换芯片 HL7593 更被

评选为“2023年广东省名优高新技术产品”，公司亦荣获了传音控股（股票代码：688036）颁发的“2023年度鼎力支持奖”和昆山丘钛微电子科技股份有限公司颁发的“2023年度最佳战略伙伴”等诸多荣誉，充分展现了外界对公司研发实力、产品质量与市场前景的高度认可。

（二）“内生与外延发展并重，巩固和拓展市场份额”的实施情况

2024年上半年，随着消费电子行业温和复苏，终端手机品牌客户的新品发布推动了公司业务的快速增长，公司所有产品线的出货金额约50,101.76万元，实现营业收入约23,008.84万元，较上年同期同比增长84.48%。2023年以来，公司通过与韩国上市公司 Dongwoon Anatech Co., Ltd.的交易迅速开拓了音圈马达驱动芯片产品线，包括自动对焦芯片和光学防抖芯片，目前已成为大中华区品牌手机客户的主流选择，市场占有率水平较高。公司音圈马达驱动芯片产品已进入 vivo、荣耀、传音、OPPO、小米、联想等主流消费电子客户的供应链，应用于多款消费电子终端产品中，加深了公司与现有消费电子客户的合作关系。2024年下半年，公司将积极推进该业务的自产工作，进一步增加自产产品的数量，逐步提升公司营收规模和盈利能力。

2024年，公司积极响应《中国证监会关于深化科创板改革服务科技创新和新质生产力发展的八条措施》的号召，聚焦主业的同时主动挖掘业内并购整合机会，通过吸收海内外优质标的提升产业协同效应。2024年7月，公司二级全资子公司 Halo Microelectronics International Corporation（以下简称“HMI”）与 Zinitix Co., Ltd.（以下简称“Zinitix”）的股东签署《股份购买协议》，拟以21,005,377,046韩元（折合人民币约109,391,610.49元）收购Zinitix 30.91%的股权（以下简称“本次交易”）。本次交易完成后，HMI将成为Zinitix的第一大股东并能够主导其董事会席位，并将委派财务负责人等高级管理人员，对其经营、人事、财务等事项拥有决策权，Zinitix将成为公司的控股子公司。具体内容详见公司于2024年7月15日在上海证券交易所网站披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于全资子公司收购Zinitix Co., Ltd.股权的公告》（公告编号：2024-054）。2024年下半年，公司将按照《股份购买协议》的约定积极推进交割事项，并在交割后通过整合双方的人才资源、技术储备、优质产品、供应链与销售渠道，努力实现“1+1>2”

的效果。

（三）“全方位优化内部管理努力实现‘降本增效’”的实施情况

公司把“降本增效”作为 2024 年度经营的重要任务之一，在 2024 年上半年取得的成果如下：

1. 公司积极响应“国产替代”政策，新导入了国内封测厂，通过合理安排委外生产计划，有效调配供应商资源，以降低委外生产成本。同时，公司依托 ERP 系统等数字化管理工具，持续优化供应链管理，并与核心供应商建立战略合作保障供应链安全。

2. 针对非生产性采购，公司加强供应商管理和建立长期且稳固的合作伙伴关系，通过集中采购策略和框架协议合作，实现成本大幅度降低；同时，通过精细化的风险管理，有效预防采购过程中的潜在风险，保障公司资金的安全和采购供应的稳定性。

3. 公司加强财务管理，通过把降本目标拆解至各部门，精细控制各项费用支出，提升经营效率。

（四）“研发战略优化升级加速公司创新成果转化”的实施情况

2024 年上半年，公司的研发费用为 12,020.65 万元，较上年同期增加了 5.03%，占公司营业收入的 52.24%，持续高水平的研发投入保证了公司技术和产品的先进性，进一步提高了公司的市场竞争力。其中，公司通过扩充专业技术梯队，实现研发实力的稳步提升，截至 2024 年 6 月 30 日，公司共有研发人员 189 人，占员工总数量的 66.55%，较上年同期增长 21.94%。截至 2024 年 6 月 30 日，公司研发项目的主要投向和项目进展情况具体如下：

序号	研发主要方向	主要产品	研发成果（截至2024/6/30）
1	电荷泵超级快充电路研发项目	高降压比电荷泵超级快充芯片	自2021年至今累计开展的研发项目数量为87项，累计取得发明专利数量为78项；其中，已量产的研发项目数量为33项，仍在研发项目数量为54项。
2	端口保护和信号切换电路研发项目	音频和数据切换芯片	
3	高性能DC/DC变换研发项目	DDR、GPU供电DC/DC降压芯片	
4	锂电池快充电路研发项目	Buck降压充电芯片，线性充电芯片及PMIC	
5	电荷泵超级快充电路研发项目	高压、低压2:1电荷泵超级快充芯片	
6	端口保护和信号切换电路研发项目	负载开关芯片、USB TYPE-C接口保护芯片	
7	电源转换芯片研发项目	模块家电辅助电源芯片、马达驱动芯片	
8	车规和工规模拟集成电路研发项目	高边开关、低边开关、Buck降压芯片、升压控制器、高压LDO、PMIC	
9	自动对焦及光学防抖研发项目	AF/OIS技术相关的音圈马达驱动芯片	

公司高质量的知识产权布局稳步推进。截至2024年6月30日，公司累计取得国内外专利78项，均为发明专利，另有集成电路布图设计专有权9项。其中，2024年1至6月获得新增授权专利9项，新增集成电路布图设计专有权4项。

另外，值得一提的是，2024年2月，公司被佛山市人民政府评为“2023年度佛山市科技领军企业（科技创新创业团队）”；2024年3月，公司获得ISO 26262:2018汽车功能安全ASIL D流程认证证书，意味着公司已建立完善且合规的功能安全开发流程体系，足以应对汽车行业最为严苛的功能安全场景，能为全球汽车厂商和Tier 1供应商交付更安全、可靠、稳定的芯片产品；2024年7月，公司被佛山市科学技术局认定为“2024年度佛山市工程技术研究中心（佛山市集成电路芯片工程技术研究中心）”。

（五）“稳健的人才政策打造多元化、高效能的人才队伍”的实施情况

公司通过校招、校招、以优秀吸引优秀的内推等方式持续拓宽人才引进渠道，丰富公司人才储备，2024年上半年共有31人入职公司，其中新入职的研发人员有26人。截至2024年6月30日，公司共有员工284人，稳健的人才政策初见

成效。

2024年上半年，公司继续实施常态化股权激励，建立激励与约束机制，以保持科研和业务团队的稳定。2024年3月，公司实施了新一期股权激励计划——2024年股票期权激励计划，分别以14.38元/份、10.66元/份的行权价格向149名激励对象授予共计1,098.25万份股票期权，具体内容详见公司分别于2024年3月30日、2024年7月27日在上海证券交易所网站披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2024-035）、《希荻微电子集团股份有限公司关于向2024年股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》（公告编号：2024-060）。

二、“优化财务管理水平，提升经营效率与效果”相关措施的实施情况

（一）“健全公司资金管理体系，提高资金使用效率”的实施情况

2024年上半年，公司贯彻执行全面预算管理制度，通过预算的执行和监控，有效地控制成本，实现资源的优化配置，公司除职工薪酬外期间费用占营业收入同比降低20.9个百分点。同时，公司强化业财融合，共同推动落实应收账款分析、管理及改善。

截至2024年6月30日，公司募集资金投入主要情况如下：

单位：元

序号	项目名称	承诺投资总额	调整后投入募集资金金额	累计投入募集资金金额
1	高性能消费电子和通信设备电源管理芯片研发与产业化项目	167,156,600.00	167,156,600.00	161,216,743.23
2	新一代汽车及工业电源管理芯片研发项目	85,315,600.00	85,315,600.00	58,942,903.14
3	总部基地及前沿技术研发项目	239,217,900.00	239,217,900.00	17,955,039.80
4	补充流动资金	90,000,000.00	90,000,000.00	90,000,000.00
承诺投资项目小计		581,690,100.00	581,690,100.00	328,114,686.17
1	永久补充流动资金	不适用	190,000,000.00	189,037,123.17

序号	项目名称	承诺投资总额	调整后投入募集资金金额	累计投入募集资金金额
2	回购公司股份	不适用	42,202,158.37	42,202,158.37
3	其他超募资金	不适用	407,516,267.88	-
	超募资金小计	不适用	639,718,426.25	231,239,281.54
	合计	-	1,221,408,526.25	559,353,967.71

2024年下半年，公司将严格按照相关规定审慎使用募集资金，积极有序推进上述募投项目进行项目建设，力争早日全面投入使用，以满足客户对产品多样化和产品性能提出的更高要求。

（二）“优化存货管理策略，提高存货周转效率”的实施情况

截至2024年6月30日，公司存货余额为22,880.19万元，较上年年末减少14.5%，主要是由于今年上半年销售同比增长较多，存货库存消耗速度有所提升。2024年下半年，公司将持续优化存货管理策略，对销售数据进行深入挖掘和分析，提高销售预测的准确性，以合理设定存货水平，避免过高或过低的库存积压；进一步加强与晶圆厂和封装厂的战略合作，建立更为高效的生产运营和质量管理体系，加强供应链协同管理，与供应商建立长期稳定的合作关系，确保供应链的顺畅运作，减少供应链中的不确定性；加强产能保障和库存风险之间的动态平衡管理，设定合理的存货周转率目标，并建立相应的考核机制，定期对存货周转率进行监控和分析，及时发现并解决问题，提高经营效率。

三、“完善公司治理，走高质量发展之路”相关措施的实施情况

（一）“完善公司治理制度，促进公司规范运作”的实施情况

2024年上半年，公司根据实际情况，修订了《证券投资与金融衍生品交易管理制度》，新修订的《证券投资与金融衍生品交易管理制度》已于2024年4月27日在上海证券交易所网站披露。2024年4月，公司组织相关人员参加由广东上市公司协会主办的新《公司法》专题培训活动，以更好地理解新《公司法》的核心要义，在优化公司治理、规范投融资行为、股东权利保护等方面全面适应新的法律环境。2024年下半年，公司将根据新《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及证监会、上海证券交易所下发的一系列法规规定的要求，及时

进行《公司章程》及相关制度的修订和完善。

（二）“强化‘关键少数’责任，提高其合规履职能力”的实施情况

2024年上半年，公司积极组织实际控制人以及董监高等“关键少数”参加由证监局、上海证券交易所、上市公司协会等监管单位举办的各类培训共计5场，培训内容涵盖并购重组实务、上市公司独立董事制度改革解读、上市公司规范治理以及新《公司法》修订要点等方面。通过一系列培训，使“关键少数”更加准确地理解最新的监管理念和规则要求，提高其履职能力。

四、“加强投资者沟通，传递公司价值”相关措施的实施情况

2024年上半年，公司切实履行信息披露义务，披露了2份定期公告和51份临时公告，公告类型包括募集资金使用与管理、回购股份、股权激励、股东大会、股东减持股份等方面，通过高质量和高透明度的信息披露工作，从而加深投资者对公司的了解，为其提供准确的投资决策依据，切实保护广大投资者的合法权益。同时，公司通过微信公众号、视频号等新媒体宣传平台以及广播电视、网络媒体等宣传渠道，全方位、多渠道宣传公司生产经营、研发创新、市场拓展等方面工作，积极传递公司价值，进一步提升了公司品牌影响力。

2024年5月13日，公司参加2023年度芯片设计专场集体业绩说明会暨2024年第一季度业绩说明会，针对公司2023年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通。截至2024年6月30日，公司通过上海证券交易所“e互动”平台回复投资者问题共计17条，回复率为100%；开展投资者活动共计5场，接待投资者共计209人次；通过电话热线接听投资者咨询60条。公司通过多样化的渠道，持续与投资者保持良性互动，增强了投资者对公司的参与度和认同感。

2024年4月27日，公司在上海证券交易所网站披露了中英文版本的2023年度环境、社会与公司治理（ESG）报告，向海内外投资者展示公司在可持续发展和履行社会责任方面的实践，以助力加强与国际投资者建立更加紧密的联系。根据Wind的数据显示，截至目前，公司的ESG评级为BB。2024年下半年，公司将继续推进和优化ESG建设，推动公司可持续发展，并定期披露环境、社会与公司治理（ESG）报告。

五、“共享发展成果，注重投资者回报”相关措施的实施情况

（一）“实施回购，提振市场信心”的实施情况

2024年1月24日，公司将回购证券专用账户中的811,000股已回购股份予以注销。本次股份注销有利于增厚每股收益，进一步提振投资者信心，切实提高股东的投资回报。

2024年5月20日，公司完成第二次股份回购，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份2,184,196股，支付的资金总额为人民币27,194,546.85元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。具体详见公司于2024年5月21日在上海证券交易所网站披露的《希荻微电子集团股份有限公司关于股份回购实施结果的公告》（公告编号：2024-049）。

2024年下半年，公司将继续践行“以投资者为本”的理念，持续关注并监控公司股价走势，根据市场情况和公司财务状况，审慎决策，适时开展股份回购以稳定股价，保障投资者的利益。

（二）“完善投资者回报机制”的实施情况

2024年下半年，公司将重新审阅股东回报规划，制定并披露《未来三年（2024年-2026年）回报规划》。公司在制定现金分红政策时，将综合考虑自身盈利水平、资金支出安排和债务偿还能力，兼顾投资者回报和公司发展需要，以建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划与机制，后续亦将严格执行分红政策，在符合条件的情况下积极推动对广大股东的利润分配以及现金分红，强化对投资者的回报机制。

六、其他事宜

截至目前，公司尚未收到投资者关于改进行动方案的意见建议等；后续实施过程中，公司将持续关注投资者反馈，结合公司实际情况及投资者关切问题，不断优化行动方案并持续推进方案的落地，并及时履行信息披露义务。公司将继续专注主业，提升经营质量，并以良好的业绩表现、规范的公司治理积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，回报投资者信任，维护公司良好市场形象，促进资本市场平稳健康发展。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成

公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

（以下无正文）

希荻微电子集团股份有限公司董事会

2024年8月29日